

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、综合授信情况及担保情况概述

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4月24日、2020年5月18日分别召开第二届董事会第十六次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司2020年度向金融机构申请总额不超过4亿元人民币（或等值外币）的综合授信，授信期限为1年至5年；同意公司2020年度对子公司（深圳市君安宏图技术有限公司（以下简称“君安技术”）、深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称“泰博迅睿”）等）提供连带责任担保，担保额度累计不超过2亿元人民币（或等值外币），在此额度内，具体由子公司根据业务发展需要选择金融机构及融资金额。

具体内容详见公司于2020年4月24日和2020年5月19日披露于巨潮资讯网的《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2020-023）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-030）。

二、综合授信及担保的进展情况

公司近期与以下金融机构签署了授信额度协议或借款协议：

1、2020年9月，泰博迅睿公司已向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请流动资金借款并签署了《授信额度协议》，授信额度为人民币1,000万元，额度有效期间自签署日起至2021年9月22日止，同时本公司及相关方就本次事宜提供担保。

2、2020年9月，君安技术公司已向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请流动资金借款并签署了《授信额度协议》，授信额度为人民币1,000万元，额度有效期间自签署日起至2021年9月21日止，同时本公司及相关方就本次事宜提供担保。

3、2020年9月，广微集成技术（深圳）有限公司公司已向中国银行股份有限公司深圳

南头支行申请流动资金借款并签署了《授信额度协议》，授信额度为人民币800万元，额度有效期间自签署日起至2021年9月23日止，同时本公司及相关方就本次事宜提供担保。

4、2020年10月，泰博迅睿公司下属香港公司泰博设计有限公司已向香港上海汇丰银行有限公司申请流动资金借款并签署了借款协议，借款额度为200万美元，额度有效期为一年且到期后银行复核延续，同时本公司及相关方就本次事宜提供担保。

5、2020年11月，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款并签署了《流动资金借款合同》，金额为人民币2,000万元，有效期间自提款之日起1年，本次事宜不设任何担保。

6、2021年1月，公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请流动资金借款并签署了《授信额度协议》，授信额度为人民币1,000万元，额度有效期间自签署日起至2021年12月2日止，本次事宜不设任何担保。

三、综合授信、借款及担保协议的主要内容

（一）泰博迅睿公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行授信协议的主要内容

- 1、借款人：深圳市泰博迅睿技术有限公司
- 2、贷款人：中国银行股份有限公司深圳南头支行
- 3、保证方：深圳市民德电子科技股份有限公司、高枫、潘剑华
- 4、授信金额：人民币 1,000 万元
- 5、授信期间：合同签署日起至 2021 年 9 月 22 日止
- 6、借款利率：根据实际借款情况确定
- 7、借款用途：短期流贷

注：高枫为泰博迅睿公司的董事、总经理、法定代表人。潘剑华为高枫的配偶。

（二）君安技术公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行授信协议的主要内容

- 1、借款人：深圳市君安宏图技术有限公司
- 2、贷款人：中国银行股份有限公司深圳南头支行
- 3、保证方：深圳市民德电子科技股份有限公司、舒征
- 4、授信金额：人民币 1,000 万元
- 5、授信期间：合同签署日起至 2021 年 9 月 21 日止
- 6、借款利率：根据实际借款情况确定
- 7、贷款用途：短期流贷

注：舒征为君安技术公司的董事、总经理、少数股东。

（三）广微集成技术（深圳）有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行授信协议的主要内容

- 1、借款人：广微集成技术（深圳）有限公司
- 2、贷款人：中国银行股份有限公司深圳南头支行
- 3、保证方：深圳市民德电子科技股份有限公司、谢刚、董庆琳
- 4、授信金额：人民币 800 万元
- 5、授信期间：合同签署日起至 2021 年 9 月 23 日止
- 6、借款利率：根据实际借款情况确定
- 7、贷款用途：短期流贷

注：谢刚为广微集成技术（深圳）有限公司的董事、总经理、法定代表人。董庆琳为谢刚的配偶。

（四）泰博设计有限公司与香港上海汇丰银行有限公司借款协议的主要内容

- 1、借款人：泰博设计有限公司
- 2、贷款人：香港上海汇丰银行有限公司
- 3、保证方：深圳市民德电子科技股份有限公司、高枫
- 4、额度金额：200 万美元
- 5、借款期间：额度有效期为一年且到期后银行复核延续
- 6、借款利率：根据实际借款情况确定
- 7、贷款种类：货物买卖贷款

注：高枫为泰博设计有限公司的董事。

（五）本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行借款合同的主要内容

- 1、借款人：深圳市民德电子科技股份有限公司
- 2、贷款人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
- 3、保证方：无
- 4、借款金额：人民币 2,000 万元
- 5、借款期间：自提款之日起 1 年
- 6、借款利率：一年期 LPR+60BPS
- 7、贷款种类：短期流动资金贷款

(六) 本公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行授信协议的主要内容

- 1、借款人：深圳市民德电子科技股份有限公司
- 2、贷款人：中国银行股份有限公司深圳南头支行
- 3、保证方：无
- 4、授信金额：人民币 1,000 万元
- 5、授信期间：合同签署日起至 2021 年 12 月 2 日止
- 6、借款利率：根据实际借款情况确定
- 7、贷款用途：短期流贷

向以上金融机构申请的综合授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司实际发生的融资金额为准。

四、累计综合授信及对外担保金额及逾期担保金额

截至目前，公司及子公司累计获取的金融机构授信（借款）额度约为人民币 18,713 万元（或等值外币），占公司 2019 年度经审计净资产的 37.67%；实际借款金额约为人民币 14,147 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 28.48%。公司向子公司就金融机构借款事宜提供的担保总额约为人民币 11,002 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 22.15%。除此之外，公司及子公司无任何对外担保。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1、相关授信、借款和担保协议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2021年1月11日